

深圳市科技创新委员会

深圳市国家自主创新示范区管理委员会
深圳市高新技术产业园区管理委员会
深圳市外国专家局

请输入搜索内容

您的当前位置： [首页](#) > [政务公开](#) > [通知公告](#)

深圳市科技创新委员会关于发布2023年度集成电路专项资助计划项目申请指南的通知

信息来源：深圳科技创新委员会

发布时间：2022-05-06 18:47

A+ | A-

各有关单位：

深圳市科技创新委员会2023年度集成电路专项资助计划项目申请指南已发布，请按照指南要求积极申报。有关注意事项如下：

网上填报受理时间：2022年5月6日-2022年6月17日（截止24:00）。申报单位申报时需在深圳市科技业务管理系统完成提交，暂不需提交纸质材料。申报单位按业务流程获得本项目拟立项资助时，须提交纸质申请材料。我委将另行通知提交纸质材料的时间和方式。

特此通知。

深圳市科技创新委员会

2022年5月5日

附件下载

[附件1：深圳市科技创新委员会2023年集成电路专项资助计划项目申请指南.docx](#)[附件2：知识产权合规性声明（参考模版）.docx](#)[附件3：科研诚信承诺书（模板）.docx](#)

隐私声明 - 版权保护 - 网站帮助 - 友情链接 - 网站地图 - 投诉渠道

主办单位：深圳市科技创新委员会（深圳市高新技术产业园区管理委员会）@2018 版权所有 Copyright@2018. All rights reserved.

网站标识码：4403000018 粤ICP备18010673号-1 粤公网安备 44030402002884号 通讯地址：深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼

